

台光電子材料股份有限公司

全球環保暨高階基材的領航者

法人說明會簡報
114年5月

免責聲明

本簡報之內容可能包括本公司基於從各項來源所取得的資訊，對於營運、財務狀況與企業發展情形的前瞻性預估。

因為包括但不限於市場需求、價格波動、競爭態勢、供應鏈變動、全球經濟局勢、匯率波動及其他本公司無控制力之風險等各種因素，實際的營運、財務狀況與企業發展情形，可能會與本公司於預測中明示或默示敘述有差異。

本簡報之內容若有對未來之前瞻性預估，僅反映本公司於發佈當時之看法。本公司並無義務於日後情況變更時，更新前瞻預估。

會議議程

第一季營運成果	P.4
領先同業持續擴大	P.8
台光電成長優勢	P.10
-技術	
-規模 / 生產據點分散	
問答時段	P.13

第一季綜合損益表

單位:新台幣百萬元

	1Q25	4Q24	1Q24	季變化	年變化
營業收入	21,680	18,562	12,902	16.8%	68.0%
營業毛利	6,590	5,281	3,738	24.8%	76.3%
營業利益	4,540	3,525	2,536	28.8%	79.0%
繼續營業部門稅前淨利	4,667	3,370	2,614	38.5%	78.6%
所得稅費用	(1,200)	(726)	(637)	65.3%	88.5%
稅後淨利	3,467	2,644	1,977	31.1%	75.4%
基本每股盈餘(新台幣元)	10.01	7.67	5.76	30.5%	73.8%
營業毛利率(%)	30.4%	28.5%	29.0%	+1.9 ppts	+1.4 ppts
營業利益率(%)	20.9%	19.0%	19.7%	+1.9 ppts	+1.2 ppts
稅後淨利率(%)	16.0%	14.2%	15.3%	+1.8 ppts	+0.7 ppts
股東權益報酬率	41.7%	27.3%	30.5%		

第一季資產負債表及重要財務指標

單位:新台幣百萬元

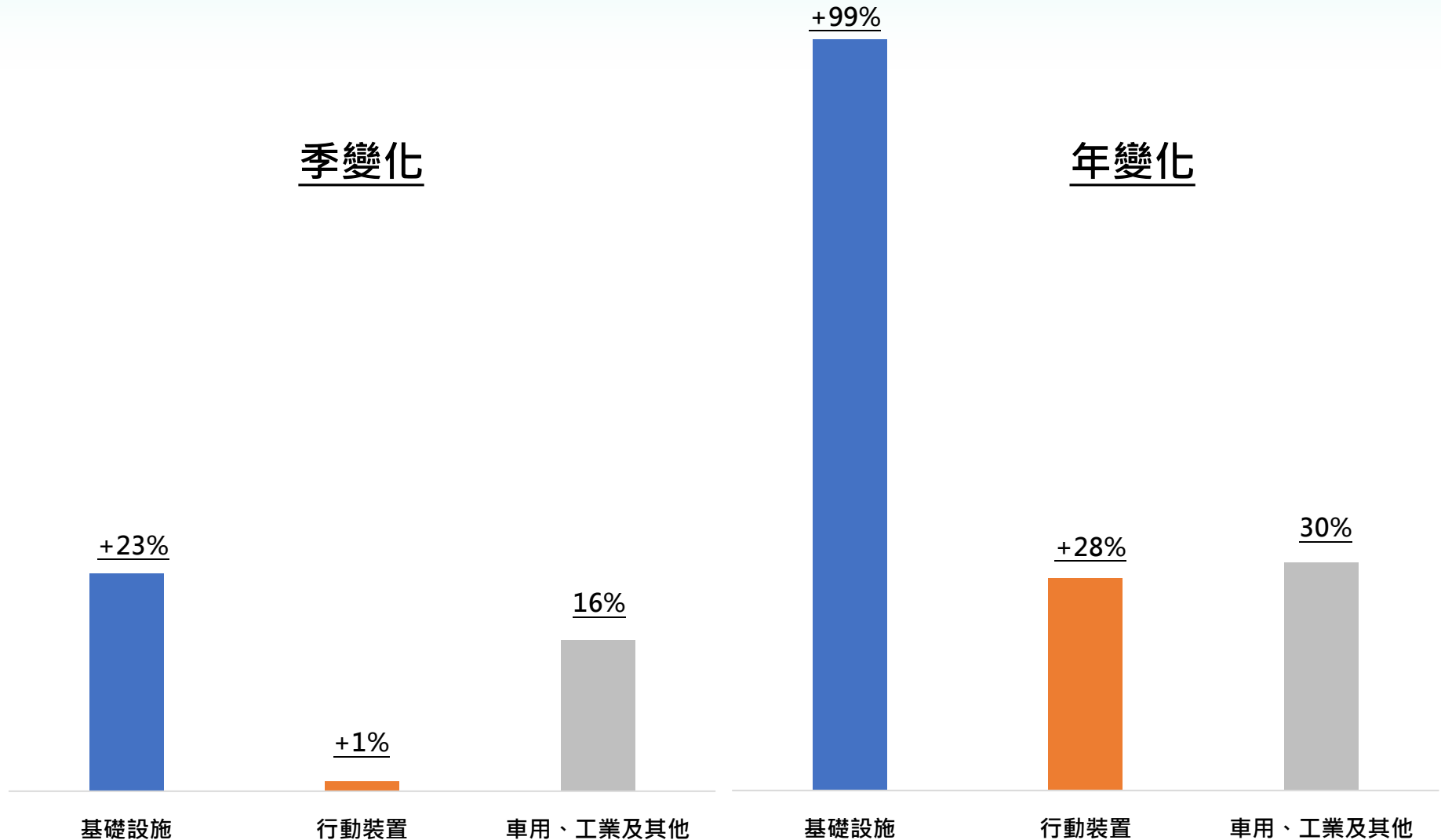
	1Q25		4Q24		1Q24	
	金額	%	金額	%	金額	%
現金及約當現金	18,427	21.1%	14,988	19.7%	12,625	21.3%
應收帳款+應收票據	30,239	34.6%	25,897	34.0%	17,963	30.3%
存貨	10,558	12.1%	9,437	12.4%	6,668	11.2%
不動產、廠房及設備	23,842	27.3%	21,387	28.1%	17,838	30.1%
資產總計	87,415	100.0%	76,080	100.0%	59,277	100.0%
短期借款	9,040	10.3%	7,781	10.2%	10,859	18.3%
應付帳款	18,053	20.7%	15,963	21.0%	10,648	18.0%
長期借款	11,385	13.0%	8,772	11.5%	1,881	3.2%
業主權益	33,272	38.1%	35,094	46.1%	25,965	43.8%
負債及權益	87,415	100.0%	76,080	100.0%	59,277	100.0%
重要財務指標						
平均收現日數	118		122		125	
平均銷貨日數	60		61		64	
流動比率 (倍)	1.5		1.7		1.3	

第一季銷售分析-產品組合

基礎設施的強勁增長反映高端材料市佔率提升

季變化

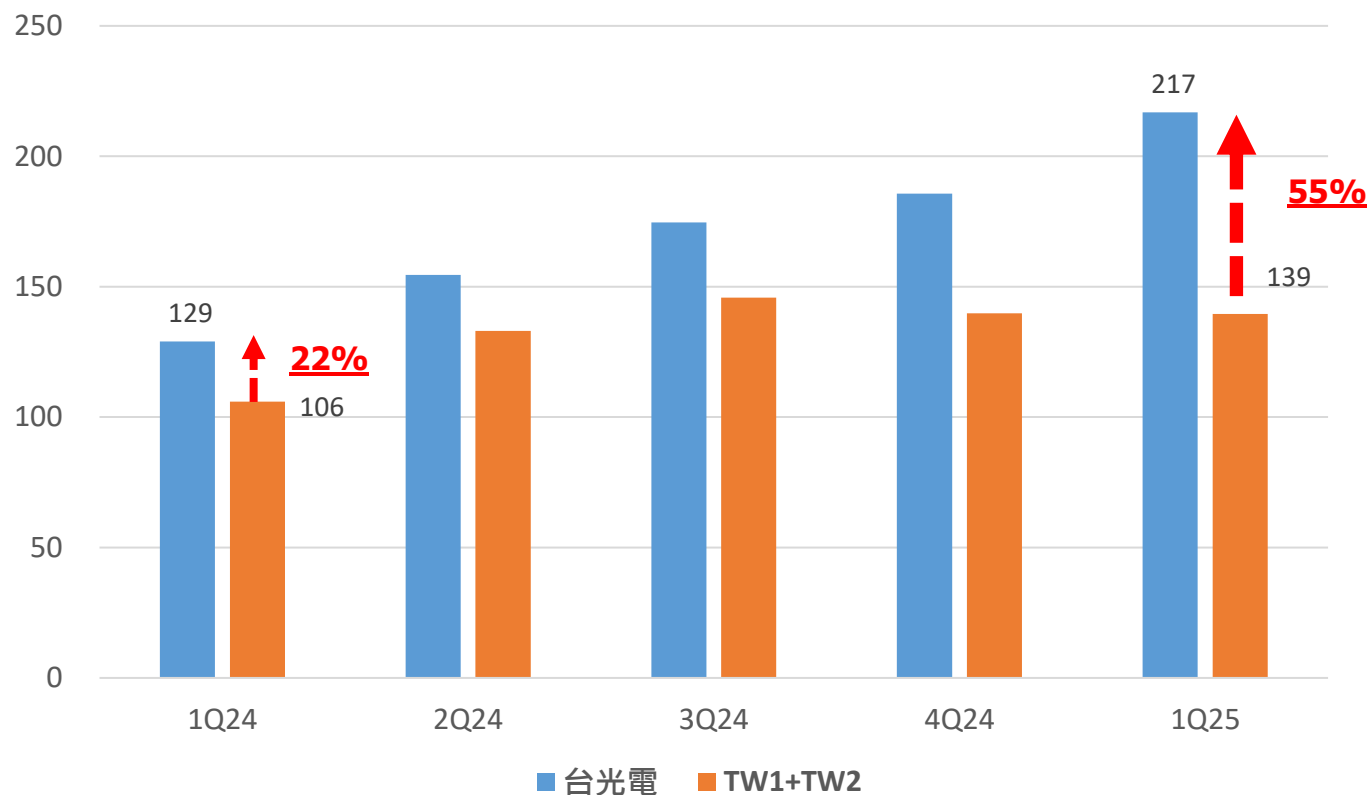
年變化



領先同業持續擴大

第一季營收比同業總和高出55% (去年同期為 22%)

新台幣億元

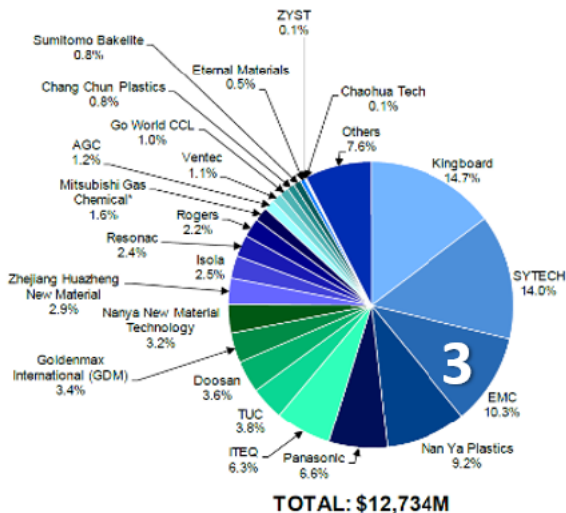


領先同業持續擴大

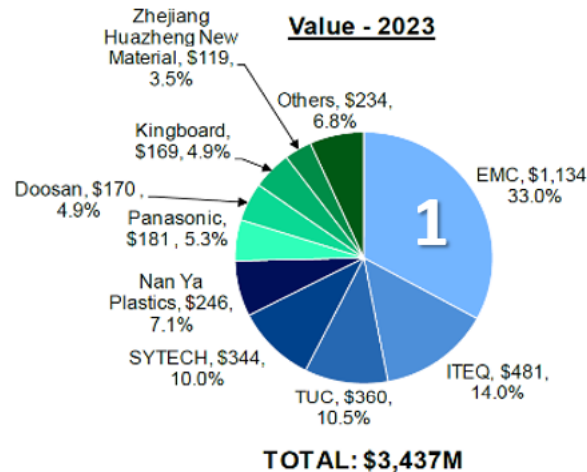
2023 年高速材料全球排名第一，且市佔率持續成長中

- Global No. 1 – mSAP, HDI, Halogen-Free laminate provider.
- Global No. 1 – High-Speed Laminate provider.

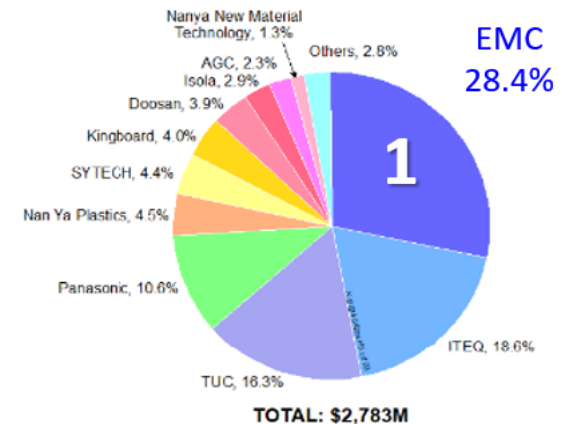
Laminate Market



Green Laminate Market



High-Speed Laminate Market

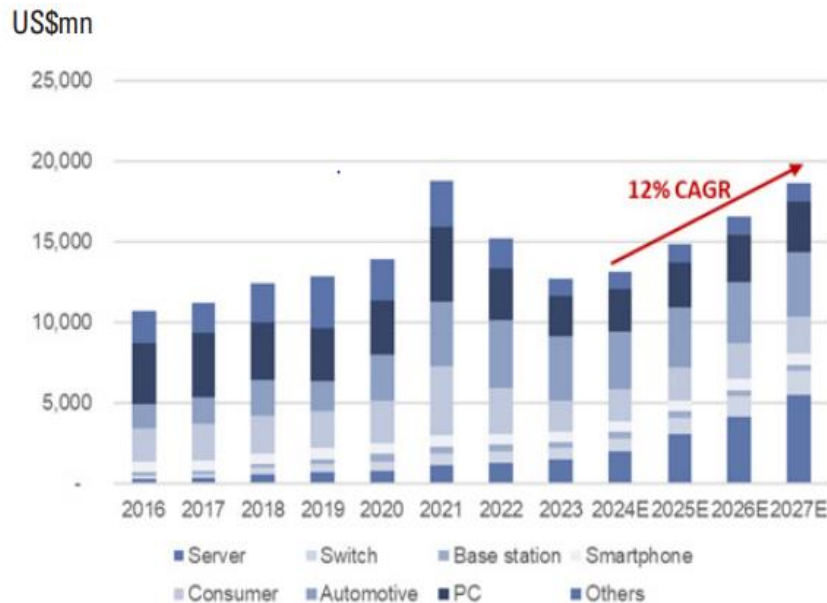


- By Revenue
- Mass Lam Sales is excluded.

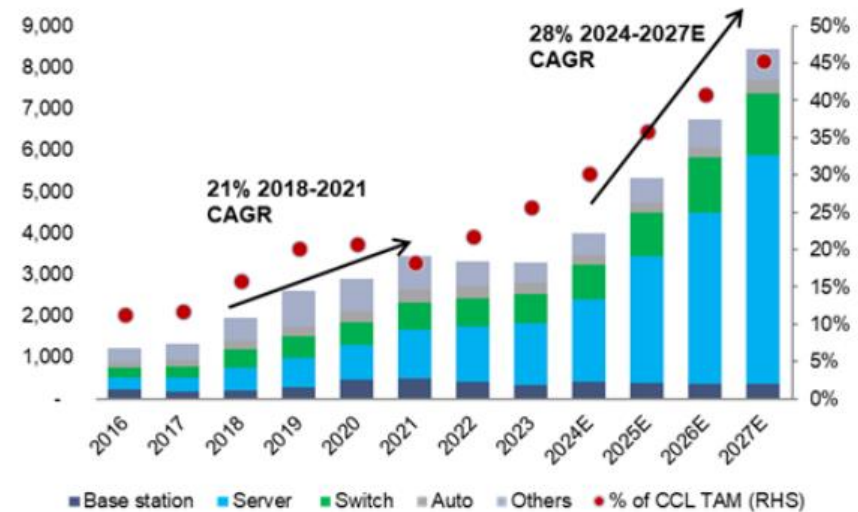
領先同業持續擴大 高階CCL (HDI & 高速高頻)

- 高階銅箔基板市場年複合成長率 **28% (2024-2027)**
- 銅箔基板市場年複合成長率 **12% (2024-2027)**
- 台光電成長率將高於高階銅箔基板市場

Overall CCL Market

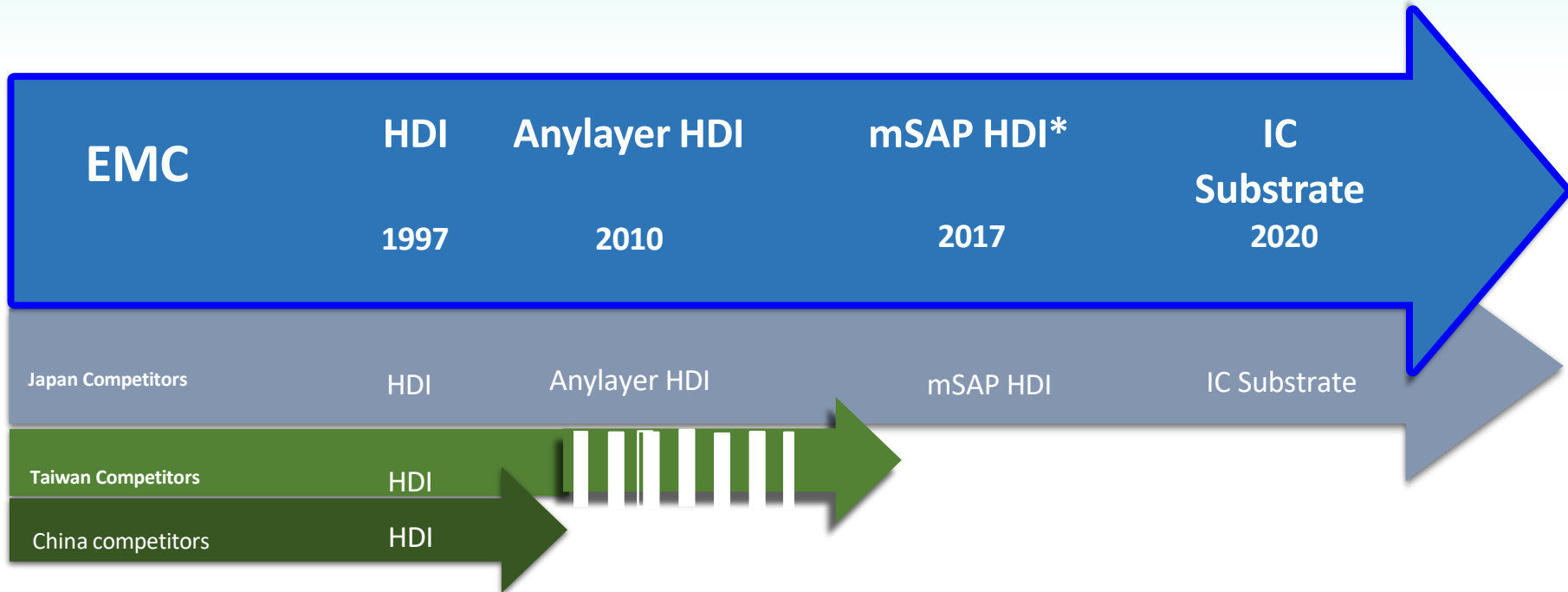


High-end CCL Market



台光電成長優勢

HDI 技術領先



*日韓以外，唯一一家擁有 mSAP 與載板材料製造商; 100%採用自有研發技術

台光電成長優勢 規模及全球佈局

California, US



ARLON
ELECTRONIC MATERIALS

**EMC: Exclusive Asian CCL Supplier
with US Production Capability**

Kunshan, China



Huangshi, China



300K shts/mon
Q2 2025

Guanyin, Taiwan



Zhongshan, China



600K shts/mon
Q4 2025

Penang, Malaysia



600K shts/mon
Q3 2025

EMC: Dominant CCL Capacity in Southeast Asia.
(Competitors provide less capacities or incomplete production capabilities)

Site Capacity		Laminate (SHTs/mon)	Prepreg (meter/mon)
HQ	(TW)	0.65 M	1.6 M
Kunshan	(CN)	1.80 M	4.1 M
Zhongshan	(CN)	0.95 M	2.2 M
Huangshi	(CN)	0.90 M	4.8 M
Total (2024)		4.30 M	12.7 M
Huangshi	(CN)	0.30 M	0.2 M
Penang	(MY)	0.60 M	0.9 M
Zhongshan	(CN)	0.60 M	0.9 M
Total (2025)		5.80 M	14.7 M

企業社會責任報告書

EMC



bsi.



Q & A